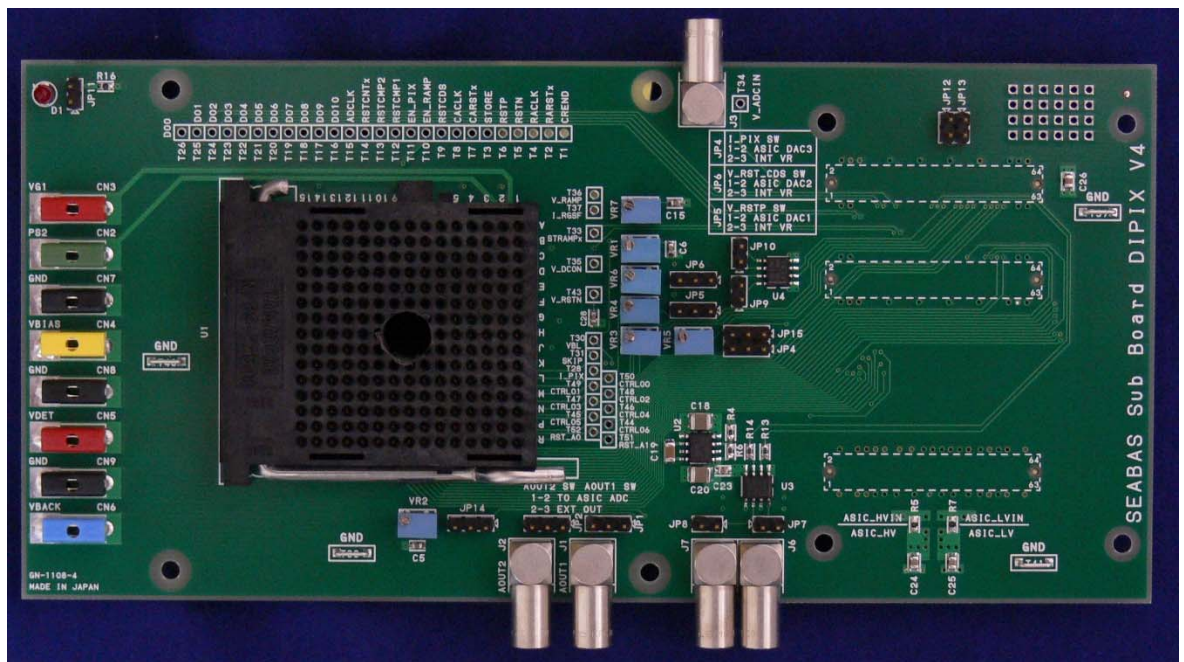


# GN-1108-4 SEABAS SUB BOARD DIPIX1 V4

SEABAS サブボード DIPIX1 V4

## 概説

本製品は、素粒子物理学実験、及び原子核物理額実験に使用される 計測用シリコンチップ評価用基板です。本製品は SOI(Silicon-On-Insulator) 技術を用いて開発されました計測チップ（ピクセルセンサー）の読み出し基板として開発されました。この SEABAS サブボード DIPIX1 基板は チップからの信号を SEABAS デジタル読み出し基板に 送る機能が有ります。（SEABAS 基板はデジタル信号処理後 外部に高速 転送の機能が有ります。）このピクセルセンサーは、位置分解能が良く X 線にも良好な感度を持ち、医療、材料分析、物質構造解析、科学機器等の学術的分野への応用が期待されている評価用センサーです。



## 特徴

### 計測チップ能力

BGA チップは 15X15 PIN 相当

X 線検出範囲 : 1keV-40keV

ゲイン : 13uV/e-

シリコン厚さ : 260um

使用電源 : 3.3V, 1.8V

消費電力 : 1W 以下

## 仕様

### チップ搭載基板 仕様

基板素材 : FR-4 4層基板 厚さ 1.6mm

基板外形寸法:90x189x20(mm) (最大)

供給電源は SEABAS (読み出し親基板) より供給されます。

有限会社 ジー・エヌ・ディー

〒294-0045 千葉県館山市北条 1716 TEL 0470-22-1115